

	Technisches Datenblatt Jtec Ag02CuP	Version / Datum	V1.0 / 04.05.2025
		Änderungsgrund	Neuerstellung
		Autor	TH
		Vorgängerversion	-

Jointec GmbH: Jtec Ag02CuP
 ISO 17672: CuP 279
 EN 1044: Cu 105
 AWS A 5.8: CuP-2

Chemische Zusammensetzung

	<i>Ag</i> [%]	<i>Cu</i> [%]	<i>P</i> [%]	<i>Andere</i> [%]	<i>Schmelzbereich</i> [°C]
Jtec Ag02CuP	2	Rest	6.3	-	645 – 825

Charakteristik / Anwendung

Jtec Ag02CuP ist ein Silber-Kupfer-Phosphor-Lot mit geringem Silberanteil. Diese Legierung bietet gute Fliesseigenschaften und Kapillarwirkung. Geeignet für Verbindungen von Kupfer mit Kupfer. Empfohlen für Lötverbindungen, die starken thermischen Belastungen und bedingten Vibrationen ausgesetzt sind.

Betriebstemperatur der Lötverbindung: –20 °C bis +150 °C.

Nicht geeignet für schwefelhaltige Umgebungen sowie für Eisen- oder Nickellegierungen.

Erwärmungsmethoden:

Flammlöten, Induktionslöten, Widerstandslöten

Flussmittel:

AgCuP werden zum Löten von Kupfer verwendet, dazu wird kein Flussmittel benötigt.

Technische Lieferbedingungen gem. ISO 17672

Verfügbarkeit

<i>Stäbe</i>	<i>Flussmittelummantelte Stäbe</i>	<i>Draht</i>	<i>Folie</i>	<i>Formteile</i>	<i>Pulver</i>	<i>Paste</i>
X	-	X	X	AA	-	-